



"IMS pool" – schede in "Insulated Metal Substrate" da Eurocircuits

"IMS pool" – order-pooling per schede in Insulated Metal Substrate

Sempre più nostri clienti stanno sviluppando schede con LED ad alta intensità, convertitori di potenza e applicazioni automotive. Sempre di più i loro progetti hanno bisogno di schede realizzate in Insulated Metal Substrate per una migliore dissipazione del calore. La nostra risposta è stata quella di creare un nuovo servizio che offra tutti i vantaggi del nostro order-pooling con un servizio per i PCB in alluminio. Con il lancio del nostro servizio "IMS pool" Eurocircuits offre il più ampio spettro della tecnologia PCB di ogni altro servizio pooling online in Europa.

Cosa otterrete?

- Un menu a pagina singola per ordinare velocemente PCB in Alluminio
- 1 layer, a partire da un singolo pezzo
- Materiali appositamente testati
- Finitura completa con un solder mask ed una serigrafia
- Finitura Lead-free HAL
- Materiale con base in Alluminio ottimizzato per la massima dissipazione del calore
- Nessun costo di attrezzatura
- Nessun minimo d'ordine
- Controllo specifiche di lavorazione al 100% prima della produzione
- Calcolo prezzi ed ordini direttamente online

Come calcolare i prezzi ed inserire gli ordini?

Accedere al sito e selezionare [Inserimento Ordine](#). Inserite le dimensioni ed il termine di consegna e il gioco è fatto - niente di più. Si vede il prezzo all'istante. Allegate file e l'ordine è inserito. Per scegliere altre opzioni andate su "specifiche tecniche" e selezionate quello che vi serve.

Nuovo Utente?

Non siete ancora registrato su **Eurocircuits** con i nostri altri servizi low_cost online? Andate su [Registrazione](#) e compilate il breve questionario.

Come facciamo a tenere i prezzi dei PCB prototipo così bassi?

In Eurocircuits siamo specializzati nella realizzazione di prototipi e piccole serie di PCB. Siamo esperti nell'order-pooling. Inserire ordini differenti sui nostri pannelli di produzione standard minimizza i costi di attrezzatura e di produzione così che i prezzi rimangano bassi e non ci siano costi per le attrezzature. Poiché riceviamo giornalmente un gran numero di ordini possiamo offrire un'ampia gamma di opzioni tecnologiche nei nostri servizi pooling. Controlliamo al 100% i vostri files prima della produzione per accertarci che riceviate ciò che avete richiesto.

Numero di layers	1
Massima dimensione PCB	425mm x 425mm
Minima dimensione PCB	5mm x 5mm
Materiale Base	T300>60", Tg135°C, >=1.3W/m-K, <=0.65°C/W, >=8.5kV, 0.58 °C-cm²/W
Spessore Materiale Base	AL 1.5mm, 75µm isolante
Spessore rame base – layers esterni	35µm/1oz
Spessore rame base – layers interni	-
Finitura superficiale	LF HAL
Soldermask Colore/tipo	LPI: Bianca, Nera
Opzioni extra	-
Colore serigrafia	Nera, Bianca
Min. Spessore/spaziatura tracce	0.150mm
Min. Misura foro finito	1.00mm
Diametro min. Piazzola layer esterno = foro finito + valore indicato	Fori ≥ 1.00: 0.350mm
Diametro min. Piazzola layer interno = foro finito + valore indicato	-
Minima distanza rame – bordo scheda – layers esterni	0.250mm (scontornato), 0.450mm (Scoring).
Minima distanza rame – bordo scheda – layers interni	-
Cave e scontornature	Utensile 2.0mm
Tipo pannelizzazione	2.0mm testimoni + Scoring (V-cut)
Build up Multilayer	-
Test elettrico	Option
Marcatura UL	Non ancora disponibile
Materiale lamina	130µm acciaio INOX
Massima misura lamina	600 x 600mm